

세계와 함께 성장하는 일류기업 이수페타시스
To be a World Wide Company ISUPETASYS

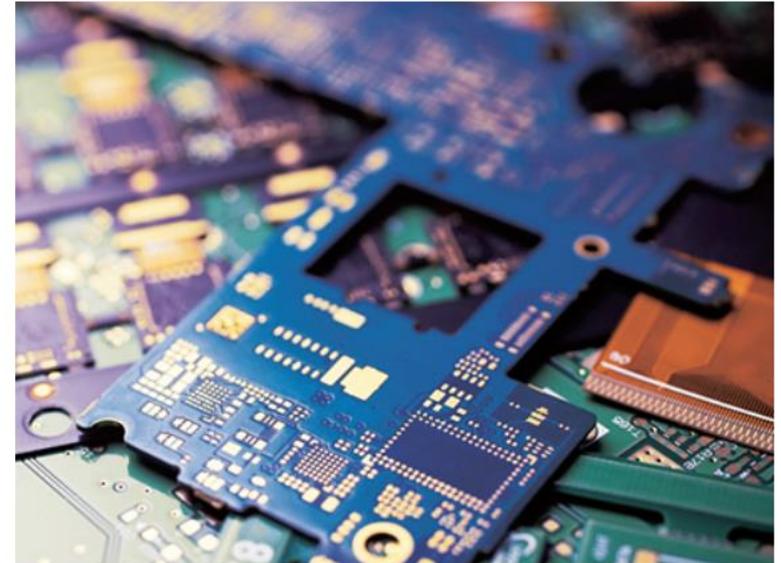


Table of Contents

01 Investment
Highlights

02 Company
Overview

03 Appendix

Disclaimer

본 자료는 투자자들에게 정보를 제공하기 위한 목적으로 (주)이수페타시스(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 임의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 자료의 열람 또는 수취는 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로, 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 사용합니다.

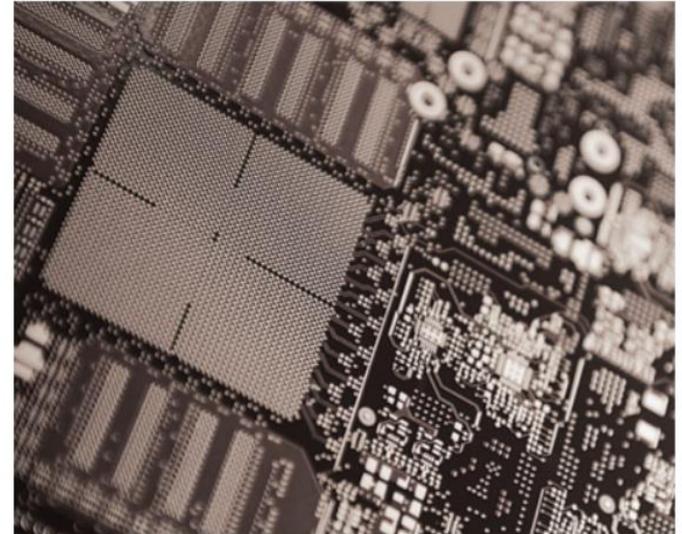
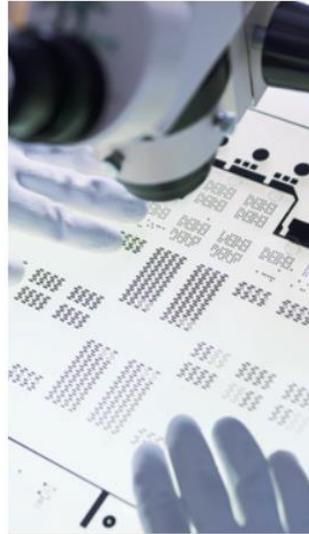
위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한 향후 전망은 발표 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 주식의 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

01



Investment Highlights

01. 각 사별 개요 및 실적추이
02. 3개년 손익/고객 추이 ('22~'24년, 별도기준)
03. '25년 매출 전망 (별도기준)
04. 수주 현황 ('24년 최근현황)
05. CAPA 투자 계획
06. 자회사(중국/미주법인) 현황

01 각 사별 개요 및 실적추이

ISU Petasys (Korea)



개요

설립년도/주요제품

- 1989년, 한국(대구)
- **초고다층 (20L↑)**
- App.
 - 시가속기
 - 네트워크/서버 장비

실적추이(매출/영업이익)

* 연결기준 '20~'24년 매출 CAGR 14% (페타 별도 21%)

구분		'20	'21	'22	'23	'24(E)
페타시스	매출	3,351	3,635	4,972	5,790	7,187
	영업이익	222	437	964	502	808
중국법인	매출	509	921	1,427	1,219	1,524
	영업이익	(107)	24	203	152	184
미국법인	매출	292	322	371	356	283
	영업이익	(36)	8	(6)	(38)	45
연결기준	매출	5,142	4,696	6,429	6,753	8,369
	영업이익	20	469	1,166	622	1,042

ISU petasys Hunan (China)



- 2013년, 중국(상탄)
- **중다층 (~18L)**
- App.
 - 네트워크/서버 장비
 - 전장

ISU petasys Corp (USA)

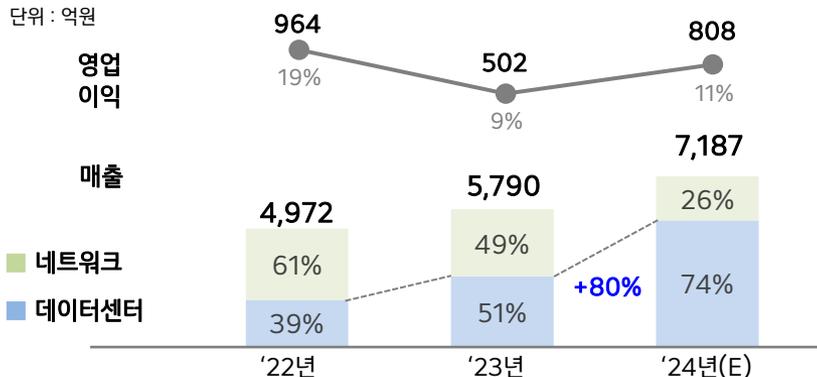


- 2001년, 미국(CA)
- **영업법인**
(생산부문 정리, '24년)

02 3개년 손익/고객 추이 ('22~'24년, 별도기준)

하이퍼스케일 데이터센터 고객 수요 강세, '24년 데이터센터 고객 매출 비중 74% 수준 확대 (YoY '24년 매출 +80.1% 성장)

매출 및 영업이익 추이 (별도)



※ 분류: 데이터센터 E사, B사, Me사, Ms사, I사 / 네트워크 A사, C사, N사 외

주요 고객 제품별 매출 현황

단위: 억원, %

구분		22년	23년	24년
데이터센터	E사	19%	32%	47%
	B사	1%	4%	12%
	Me사	13%	10%	9%
	기타	6%	5%	6%
	소계	39%	51%	74%
네트워크	A사	5%	6%	5%
	C사	12%	10%	4%
	N사	17%	8%	7%
	J사	12%	13%	3%
	기타	15%	12%	7%
	소계	61%	49%	26%
합계(억원)		4,972	5,790	7,187

현황 및 고객 Needs

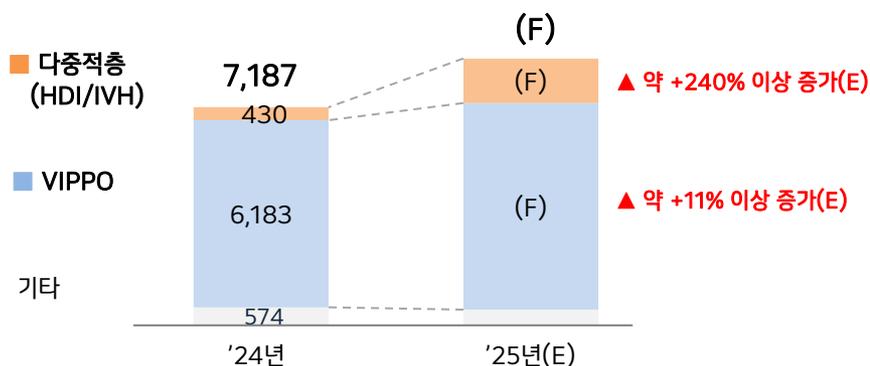
- E사 확대**
 - '22년부터 AI가속기(v4 → v6 변화) 매출 확대
 - '24년 스위치 제품(Br/Ta) 매출 확대 中 ('22년 101억, 23년 409억, 24년 1,020억)
- B사 확대**
 - H시리즈: '22년 샘플, '23년 초도 양산, '24년 매출 확대 ('22년 57억, 23년 211억, 24년 834억)
 - 최근 후속모델 오더 접수에 따른 물량 확대 전망
- Me사 확대**
 - 주요양산 제품 물량 지속
 - 800G 스위치 모델 '25년 상반기 양산 전망
- A사 확대**
 - 데이터센터 호조에 따른 400G 스위치 확대
 - '24년 하반기 800G 스위치 양산 확대
- 네트워크 약세**
 - 데이터센터 고객 대비 네트워크 고객 수주 약세
 - 24년 1Q 이후 일부 고객(C, N사 등) 회복세 (신규 800G 개발 확대 및 양산 대응)

03 '25년 매출 전망 (별도기준)

고객사 다중적층(HDI/IVH) 구조 적용하는 가속기 및 네트워크 800G 스위치 물량 증가

'25년 매출 전망

단위 : 억원



고객사별 주요 동향

고객사	전년대비		주요 동향
	동향	변화율	
E사	확대	+2.2%	<ul style="list-style-type: none"> 제품믹스 변동(스위치 제품 증가) 후속 모델 시가속기(v7) 샘플 참여 Base+OAM 물량 확대 전망 - 차기 모델 양산 시작 800G 스위치 '25년 상반기 양산 800G 양산 확대 신규 800G '25년 상반기 샘플 예정 C사 800G 양산 접수(VIPPO) N사 800G 샘플 진행(양산 미정)
B사	확대	+45.1%	
Me사	확대	+48.0%	
A사	확대	+120.2%	
C사/N사	유지	-	

가속기

샘플 현황

구분	고객사	현황
Base보드	E사	<ul style="list-style-type: none"> VIPPO: 주력모델 양산 진행 다중적층: 차기모델 샘플 참여 中
	B사	<ul style="list-style-type: none"> VIPPO: 후속 모델 승인 다중적층: 샘플 진행 中
	Ms사	<ul style="list-style-type: none"> VIPPO: 샘플 진행 中 다중적층: VIPPO → 다중적층 전환
OAM	I사	<ul style="list-style-type: none"> 다중적층: 샘플 진행 中

800G

• 800G 네트워크 물량 '25년 제품 출시 등에 수요 증가 전망

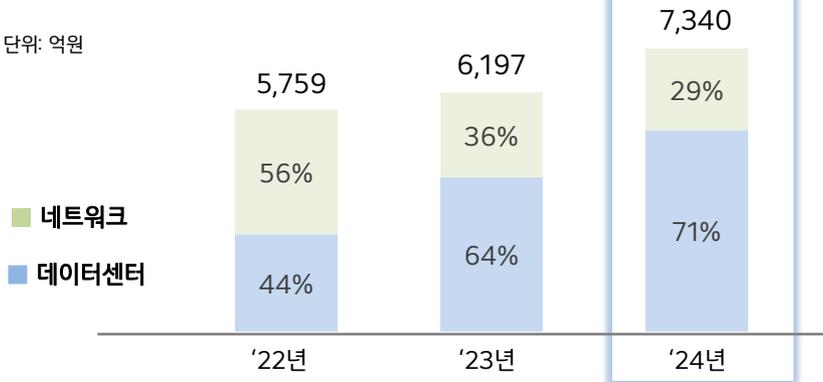
고객	샘플	양산	주요내용
A사	총 60종 이상 진행 中	진행	<ul style="list-style-type: none"> Split 확보 및 양산 진행 다중적층, 34/40L
N사		'25.2Q(E)	<ul style="list-style-type: none"> VIPPO 28-36L (800G 샘플 진행)
C사		진행	<ul style="list-style-type: none"> 800G 양산 접수 VIPPO 38L/44L
J사		진행	<ul style="list-style-type: none"> 800G 모델 양산 진행 中 다중적층, 42-46L
Me사		'25.1H(E)	<ul style="list-style-type: none"> 400G→800G 모델 변경 전망 다중적층 '25년 상반기 양산 전망

04 수주 현황 ('24년 최근현황)

AI 데이터센터 투자 확대에 따른 가속기 및 고성능 네트워크 물량 확대 中

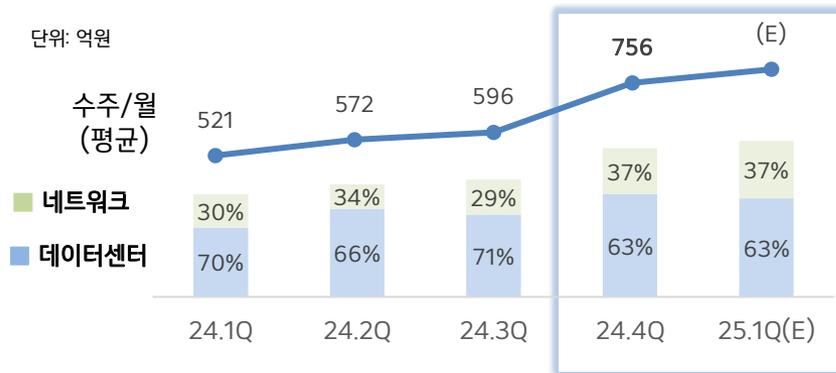
수주 추이

단위: 억원



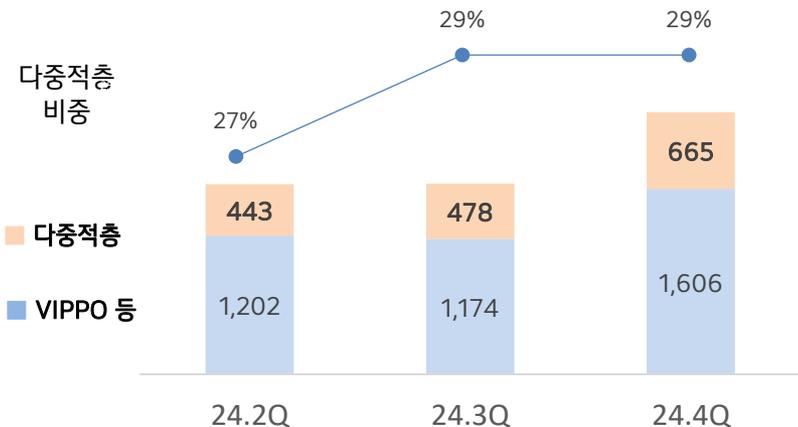
최근 수주 : '24.1Q 월평균 521억 vs 24.4Q 756억원, +45.1% 증가

단위: 억원



• 신규 샘플(NPI) 오더 추이 : 다중적층 물량 비중 확대

단위: PNL/월



• 고객사 동향

단위: 억원

구분	고객사 수주			내용(주요사항)
	고객	24.3Q	24.4Q	
가속기	E사	626	1,048	· 전방 데이터센터 투자 확대, 수요 증가 - '24년 12월 수주 400억/월 이상 확대 · '24.4Q 이후 스위치 물량 확대
	B사	336	165	
네트워크	A사	152	335	· 고성능 네트워크 물량 본격화 (24.4Q 수주 전분기대비 약 +120% 증가) · 다중적층 모델 수율 개선
	Me사	200	290	

05 시설투자(CAPA) 계획

신규 시설투자(CAPA) 진행에 따른 중장기 성장 기반 구축

투자배경

고객요구

- 다중적층 기반 제품 가시화 / Capa 확대 요구
- 800G : 시퀀셜 타입 중심
- 가속기 : HDI 타입 중심



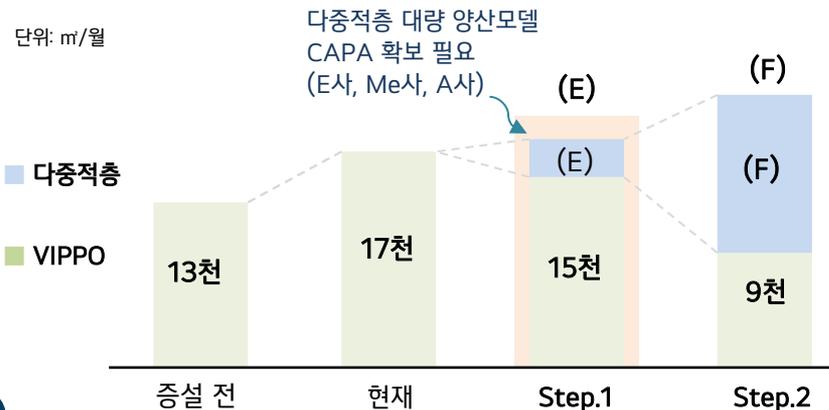
다중적층
공정부하

- 복잡하고 긴 프로세스
- 특정공정 공정부하 가중
- 적층/도금 등

• 다중적층 기술 기반 제품 가시화

구분	제품타입	양산시작	고객 의견
데이터 센터	E사	Sequential	'26년
	B사	HDI	'26년
	Aw사	Sequential	'26년
	Me사	Sequential	'25년
	Ms사	HDI	'26년
네트워크	A사,N사 외	Sequential	'24년

Step1. 다중적층 추가 CAPA 확보 예정



既往 투자 완료 ('24.3Q)

VIPPO 17천m³ 체제 구축

- 도금 CAPA 증대
- 병목공정 프로세스 최적화

'25년 투자검토 사항

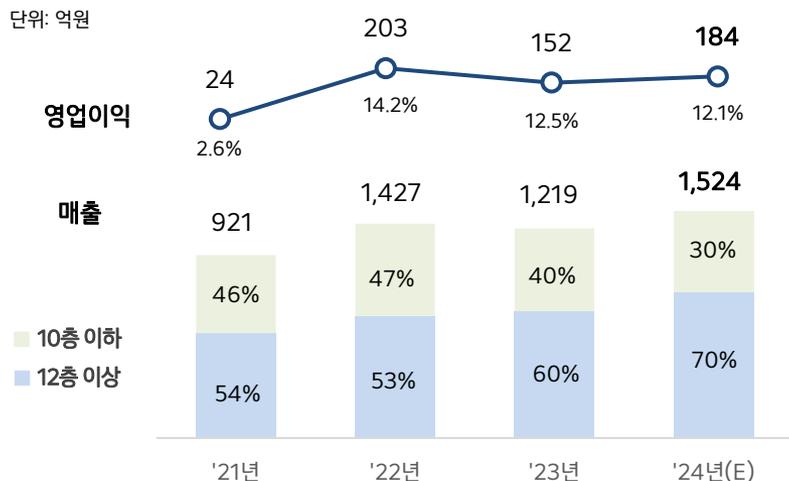
다중적층 양산 대응

- HDI 도금 기술력 확보
- 5공장 기존 건물 설비투자

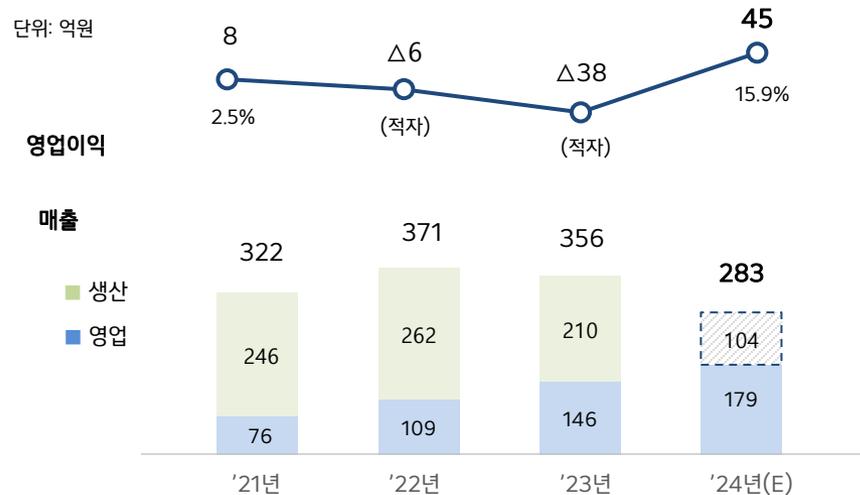
06 자회사(중국/미주법인) 현황

중국법인 중다층 비중 증가 및 수익성 확대, 미주법인 조직 구조개선에 따른 손익 Turn-around

중국법인 : 중다층 비중 증가 및 수익성 안정화



미주법인 : 조직 구조개선, 손익 Turn-around

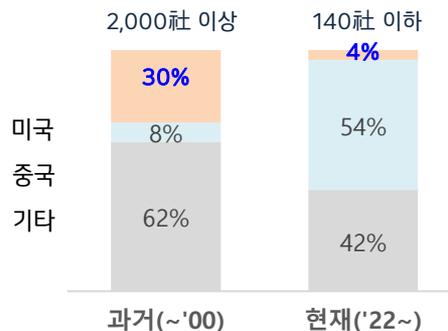


• 주요내용(상세)

구분	주요 내용
미주 고객 매출 확대	<ul style="list-style-type: none"> · 미주 고객 중심(O사, C사 등) 매출 확대 전망 · O사 신규제품 매출 증가 / C사 Std.Level 양산 연결 등 · E사 서버개발 직접 양산 승인추진 (~'25.3Q)
안정적 생산체제 구축	<ul style="list-style-type: none"> · E사 및 신규 미주고객 Site 승인 후 추가 설비투자 검토

• 생산부문 정리 배경 : 미국 PCB 시장 축소

- 미국 PCB 생산시설의 중국 이전

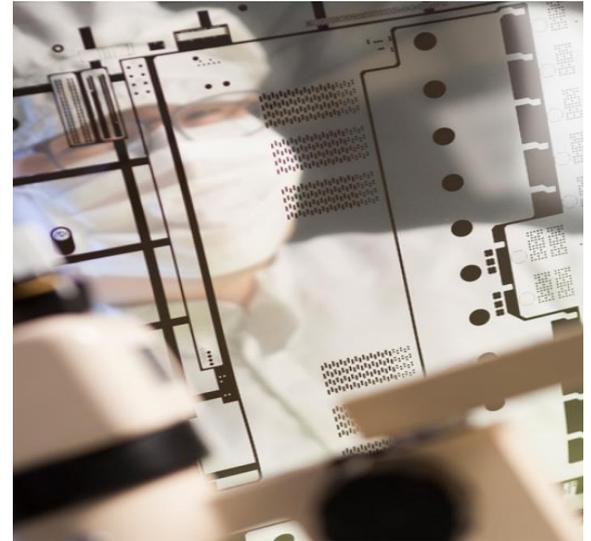


• 미국법인 중점 계획

- ✓ 미국 영업조직/기술지원 인력 강화
- 1) 신규 고객 유치 강화
- 2) 기술지원 인력(*FAE) 역량 강화
 - PCB 기술 고도화로 인한 역할 증가

※ FAE(Field Application Engineer)

02



Company Overview

01. Global PCB 업체 순위
02. 차별화된 기술력 및 CAPA 확대로 성장기반 구축
03. 글로벌 IT업체 고객사 다수 확보

01 Global PCB 업체 순위

Global 1위

(국내 MLB PCB 매출 1위)

> 고다층 PCB(18층 이상) 제조사 중 Global 매출 1위

2022년 18층 이상 PCB 업체 매출 순위
(Prsimark VHMLB PCB Market Share)

Rank	Company	18L층 이상 매출(M\$)
1	ISU Petasys (Korea)	374
2	WUS (Taiwan)	252
3	TTM (US)	239
4	Shennan (China)	175
5	Gold Circuits (Taiwan)	117
6	Tripod (Taiwan)	64
7	Sanmina (US)	59
8	Shengyi (China/HK)	57
9	Yamamoto (Japan)	55
10	Yamamoto	60
11	Others	235

Top 10 Total 1,687

World Top PCB makers in 2022

Rank	Company	Sales (M\$)
1	Zhen Ding	4,835
2	Unimicron	3,342
3	Dongshan	3,270
4	Nippon Mektron	2,479
5	TTM	2,233
6	Compeq	2,146
7	Tripod	1,919
8	Shennan	1,820
9	AT&S	1,631
10	Kinwong	1,498
39	ISU Petasys	516

Top 10 Total 53,469

*Source : Prismark Report(2023.07)

*VHMLB : Very High Multi Layer Boards

02 차별화된 기술력 및 Capa 확대로 성장기반 구축

46.7%
(투자 후 Capa 증가율%)

신공장 증축 및 자동화 투자로 MLB 생산 경쟁력 강화

납기 단축으로 신규 제품 샘플 대응 및 추가 수주 확대 전망

선도적인 기술력 및 품질

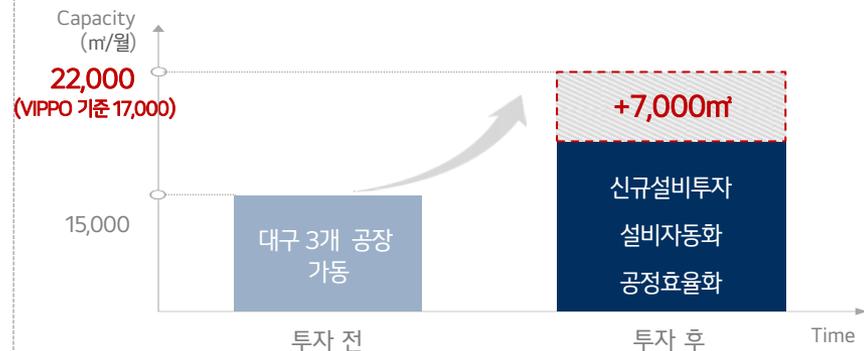
· 핵심 공정에 대한 높은 제조 기술력 보유

핵심 공정	기술 구분	기술 수준	
		자사	타사
적층/회로	적층 및 고정밀 정합 기술	44L (반도체 Test용 100L 수준)	28L 이하
도금	고정밀 도금	25 : 1	15 : 1
홀가공	고정밀 홀가공	± 3mil	± 8mil
	고난이도 홀메꿈	25 : 1	20 : 1
원자재개발	신호 고속화 측정	Ultra low Loss material (Df<0.002)	Mid loss material (Df<0.01)

※ 최근 기술 트렌드: 제품 두께 상승 및 높은 도금 능력 요구 증가
고정밀 도금 제품↑: 16:1 이상 제품 매출 증가 ('21년 39천㎡ → '23년 51천㎡)

Capa 투자 완료('24.3Q말)

① Capa 확대 (매출기준 '22년 412억/월 → '24.4Q 650억/월 (E))



② 생산 리드타임 축소

- 고객 납기 기준 16~20주 → 변경 8~10주('24.4Q)
- 신규 제품(800G/OAM) 샘플 및 양산 시간 최소화

03 Global IT 업체 고객사 다수 확보

신규고객 다수 확보

Global IT업체 중심 신규 고객 확보로 포트폴리오 다변화

AI 가속기 및 고속 네트워크 성장 산업의 신규 Major 고객 확보

고객 포트폴리오 다변화(별도기준)

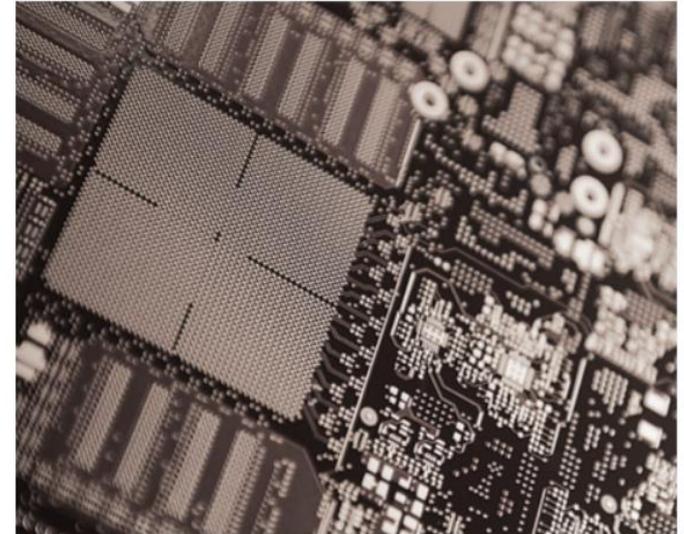
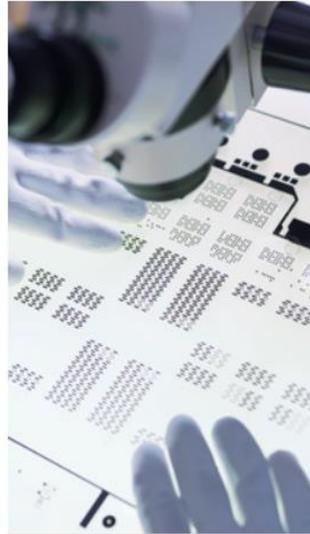
* 매출 100억/년 이상 고객사: '19년 5개사 → '24년 10개사로 확대

구분		'19년 (%)	'24년 (%)
데이터센터	E사	11%	47%
	B사	-	12%
	Me사	-	9%
	기타	-	6%
	소계	11%	74%
네트워크	A사	5%	5%
	C사	14%	4%
	N사	32%	7%
	J사	10%	3%
	기타	28%	7% (2개사)
	소계	89%	26%
합계		100%	100%

글로벌 주요 업체



03



Appendix

- 01. 유상증자 개요 및 일정
- 02. 요약재무제표
- 03. ESG평가 및 인증

01 유상증자 개요 및 일정

주주배정 후 실권주 일반공모로 진행되며, '2025년 5월 내 신주 상장을 목표로 하고 있습니다.

발행개요

구분	내용
증자방식	• 주주배정 후 실권주 일반공모
예정 발행규모	• 2,500억원
신주발행주식수	• 10,162,800 주
증자비율	• 약 16.07%
1주당 액면가액	• 1,000원
예상 발행가액	• 24,600원
할인율	• 15%
우리사주 배정비율	• 3%
대표주관회사	• NH투자증권
인수회사	• 신한투자증권/신영증권
자금사용목적(예정)	• 시설자금

※ 상기 발행개요는 변동 가능

주요일정

구분	일자
이사회결의	2025-01-23
인수계약 체결 및 증권신고서 제출	2025-02-06
1차 발행가액 산정	2025-02-20
증권신고서 효력 발생	2025-02-21
신주배정기준일	2025-02-25
신주인수권증서 상장기간	2025-03-24 ~ 2025-03-28
신주인수권증서 상장폐지	2025-03-31
최종발행가액 산정	2025-04-04
우리사주 청약	2025-04-09
구주주 청약	2025-04-09 ~ 2025-04-10
일반공모 청약	2025-04-14 ~ 2025-04-15
주금 납입	2025-04-17
신주상장일	2025-05-02

※ 상기 일정은 변동 가능

02 요약재무제표

재무상태표

단위:억원

과 목	2021	2022	2023	2024(E)
유동자산	3,103	3,739	3,819	5,216
비유동자산	1,394	1,721	2,426	2,680
자산총계	4,497	5,460	6,245	7,896
유동부채	2,982	2,860	2,901	3,744
비유동부채	260	377	700	856
부채총계	3,242	3,237	3,601	4,600
자본금	632	632	632	632
자본잉여금	637	810	810	810
이익잉여금	(54)	765	1,138	1,733
자본총계	1,255	2,223	2,644	3,296

포괄손익계산서

단위:억원

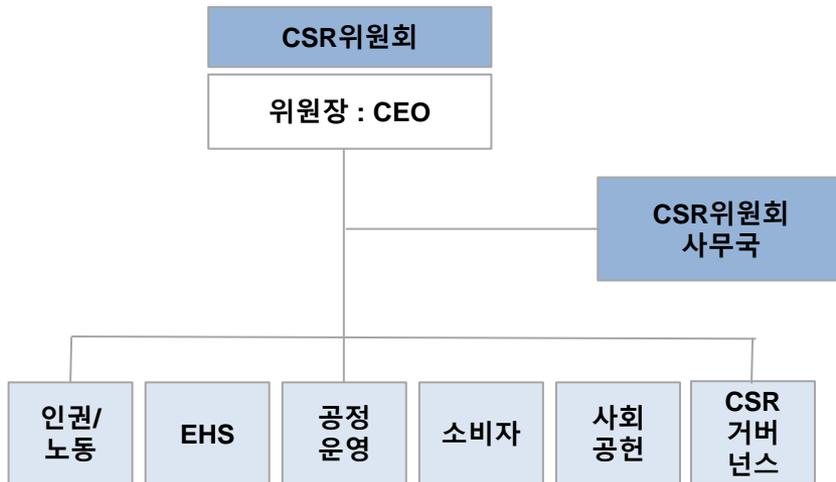
과 목	2021	2022	2023	2024(E)
매출액	4,696	6,429	6,753	8,369
매출원가	3,841	4,790	5,589	6,779
매출총이익	855	1,639	1,164	1,589
판매관리비	386	473	543	547
영업이익	469	1,166	622	1,042
영업외수익	34	39	313	400
영업외비용	9	16	388	500
법인세차감전순이익	430	1,078	547	942
법인세비용	114	75	75	181
중단영업이익(손실)	(353)	21	-	-
당기순이익	(36)	1,025	471	761

※ 연결재무제표 기준

03 ESG 평가 및 인증

CSR위원회 조직도

*CSR : Corporate Social Responsibility(사회적 책임의식)



- '15년 첫 CSR보고서 발간, CSR 성과 매년 외부 공개
→ 투명한 사회적 기업 경영 활동 진행 중

ESG 성과 평가 결과

구분		'24년	'23년	'22년	비고
서스틴베스트	상반기	A	A	AA	'24년 하반기 전체 순위 189위 (1,287사 기준)
	하반기	A	BB	AA	'섹터 內 4위 (64사)

※ 서스틴베스트_24년 성과결과표 내역

구분	점수	섹터 평균	가중치
환경(E)	73.9	34.1	25%
사회(S)	81.8	42.3	35%
지배구조(G)	58.9	53.1	40%

다수 인증 확보



TL9000('03)



AS9100('07)



Nadcap('10)



ITAR9('10)



TS16949('15)

주요 수상



"TOP Direct component supplier"('19)



"Excellence in Technology"('19)



"Supplier of the year"('08) (PCB 업계 최초)

"Excellence In Quality"('10)



"Supplier of the year"('09)

End of Document